



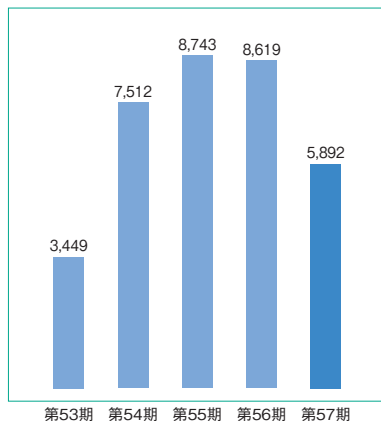
第 57 期 事業レポート

2024年4月1日～2025年3月31日

決算ハイライト(連結)

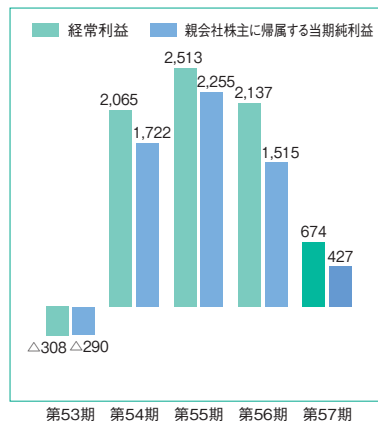
売上高

(単位：百万円)



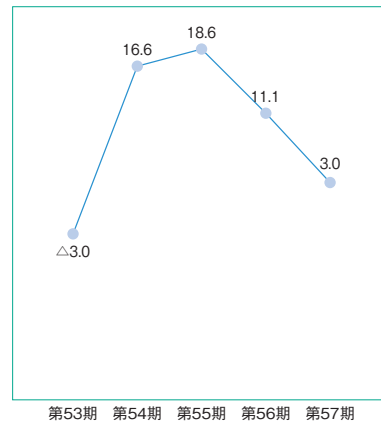
経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益

(単位：百万円)



自己資本利益率 (ROE)

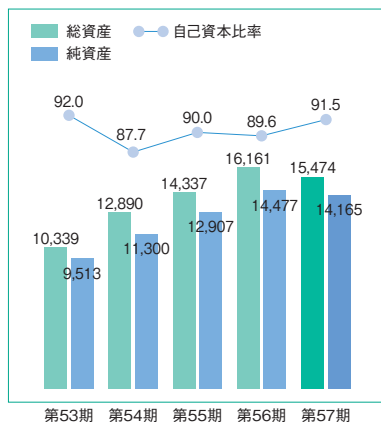
(単位：%)



総資産・純資産 自己資本比率

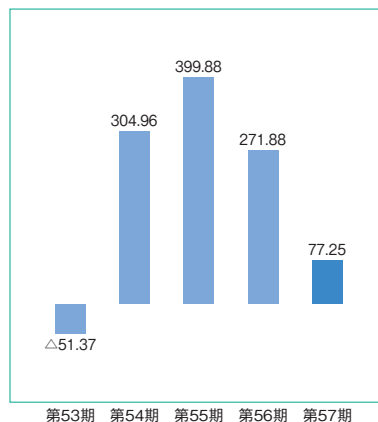
(単位：百万円)

(単位：%)



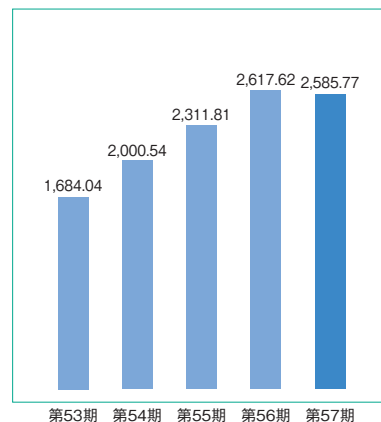
1株当たり当期純利益

(単位：円)



1株当たり純資産額

(単位：円)



トップメッセージ

平素は当社の事業運営に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

ここに第57期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）の事業の概況についてご報告申し上げます。

当連結会計年度における世界経済は、大統領選を迎えた米国では個人消費を背景として堅調に推移しましたが、インフレ鈍化を受けた利下げが実施されました。欧州でも利下げが開始され、緩やかに持ち直しました。中国では政府債務の増加と不動産市況の悪化により内需が低迷しましたが、政府による景気刺激策が一定の下支えとなりました。日本では、継続的な賃上げや歴史的な円安進行が焦点となり、追加の利上げが実施されました。

半導体業界におきましては、GPUやHBM(High Bandwidth Memory)をはじめとするAI向けの需要は好調に推移しましたが、産業機器向けは世界経済の低迷を受けて在庫調整が長期化し、パワー半導体を含む車載向けもEV需要減速の影響を受けたことから、一部顧客から出荷延期の要請を受けるなど、半導体メーカーの投資意欲は抑制傾向で推移しました。

このような状況のなか、顧客ニーズに応える製品の開発・改良に注力するとともに、パワーデバイス用テストやMAPハンドラ、自重ハンドラなどを軸として、国内外の展示会参加やトップセールスによる販売活動を展開しました。生産面では、電子部品等の部材調達難が解消した他、人材採用の強化や一部主力モデルの計画生産など、供給能力の適正化に向けた取り組みを推進しました。また、より包括的かつ迅速なテストソリューションの提供を可能とするため、協業先である国内テストメーカーを株式取得により子会社化しました。

以上の結果、受注高は40億43百万円（前期比41.3%減）、売上高は58億92百万円（同31.6%減）、期末受注残高は26億61百万円となりました。製品別売上高は、ハンドラ16億54百万円（同58.5%減）、テスト30億27百万円（同9.7%減）、パーツ等12億9百万円（同5.4%減）となりました。

損益面は、売上が3割減となり売上総利益が大きく減少したことから、営業利益は4億34百万円（同74.9%減）、経常利益は6億74百万円（同68.4%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は4億27百万円（同71.8%減）となりました。

生成AIの普及に伴うデータセンターの増強、自動運転技術



代表取締役社長 田中 賢治

(ADAS)の普及に向けたEV（電気自動車）シフトなどのカーボンニュートラルへの取り組みが世界的なトレンドとなるなか、半導体製造装置市場は、短期的には変動しつつも中長期的には堅調な成長が予想されます。

このような状況を踏まえ、当社はシクリカルな市場環境下にあっても需要拡大を背景とした中長期的な成長を目指すべく、2025～2027年度を対象期間とする中期経営計画「Enjoy2.1」を策定いたしました。

当社は、測定における提案力と付加価値の創造を通じた事業成長に向け、基盤戦略および事業戦略を着実に遂行するとともに、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に掲げる施策を一体的に推進してまいります。

また、変化の著しい半導体業界のなかで競争優位性を確立するには、自社の有する経営資源の最適化に加え、外部との戦略的連携が不可欠であると認識しております。その一環として、2025年1月には国内テストメーカーである嶺光音電機株式会社を子会社化しましたが、今後も資本提携や協業による外部リソースの活用を成長戦略の中核に位置付け、積極的に取り組んでまいります。

株主の皆様におかれましては、引き続きより一層のご支援とご指導を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

当期は需要の落ち込みから受注減となりましたが、 着実に拡大するパワー半導体市場へと強みを生かします。

生成AI関連が活況を呈する一方、EVの減速が半導体市場に影を落とした当期（2025年3月期）、テセックはどのように事業に取り組み、どのような成果を上げてきたのか。また、最近話題となっているトランプ関税の影響、新たな中期経営計画「Enjoy2.1」のポイント、パワー半導体市場の今後の展望などについて、田中社長に伺いました。

Q 当期(2025年3月期)の事業環境および業績の概要をお聞かせください。

A 当期における半導体市場は、AI向けの需要が好調に推移した一方、産業機器向けは在庫調整が長期化し、また当社の主力分野であるパワー半導体ではEV需要の減速が大きな影を落としました。

そのような状況下、当社は中期経営計画「Enjoy2.0」に則った企業価値向上策に精力的に取り組みました。しかし、EVにおいて、中国がこれまで大量に生産したこと、また世界的なEV生産の抑制などから、当期は需要が急激に落ち込み、特に下半期には国内外を問わず、顧客からの出荷延期の要請を少なからず受けることとなりました。また、ハンドラの市場回復が、想定以上に遅れていることも受注減の大きな要因となりました。

これらの結果を受けて、当期における当社の業績は、前期比で減収減益となりました。当期は「Enjoy2.0」の最終年度であり、大きな目標に向けて取り組んできましたが、期中に業績予想の下方修正を余儀なくされました。最終的には、その修正値に沿った着地となりました。

Q アメリカの政権交代の影響についてお聞かせください。

A 米国に拠点を置く半導体メーカーについては、今後どうなっていくのか、警戒感を強く抱いています。サプライチェーンの見直しを真剣に検討しているのではない

でしょうか。

もっとも当社はどうかというと、対米関連ビジネスは全体業績の1割程度であり、実際の出荷先は米国以外の地域も多いので、現状ではまだ大きな影響は及んでいないと感じています。

また、テストについては国内比率が高く、リスクは大きくはありません。ハンドラも含めて当社製品は後工程向けという事情もあり、今後も米国に直接輸出するものは多くはありません。

ただし、大きくはないにしても間接的な影響はあるでしょうから、今後の動向を注視し、慎重に判断していく必要があると思っています。

Q 当期に注力した事柄やトピックについてお聞かせください。

A 期首に多くの受注残があったので、全社を挙げてこれを遅滞なく出荷していくことに邁進しました。

一方で、前期および前々期に多数の受注をいただいた反動から、当期は受注が減少しましたが、これにより一定の生産余力が生まれました。当社はマンパワーに限りがあり、生産が逼迫している局面では、研究開発担当者も生産支援に従事せざるを得ない状況にあります。そうした中、今回の受注減少を一つの機会と捉え、腰を据えて新製品開発に取り組んでまいります。

また、研究開発体制強化の一環として、かねてより協業関係にある嶺光音電機株式会社の株式を取得し、子会

社化しました。

パワー半導体の性能が進化を続け、その測定技術も高度化する中、静特性試験に加えて、よりダイナミックな特性を検査する必要性から、動特性試験に対するニーズが年々高まってきています。同社はこの動特性試験技術を強みとしており、パワー半導体の測定において貴重な知見、豊富なノウハウを保有しています。当社と嶺光音電機が持つ技術、ノウハウの共有・統合をこれまで以上に強化することで、強力なシナジーが発揮され、より包括的かつ迅速なテストソリューションの提供が行えると考えています。

Q 新中期経営計画「Enjoy2.1」のポイントおよび、将来展望についてお聞かせください。

A 「Enjoy2.1」では、全社的な改善・改革を推進する中で、当社の核となる技術力をさらに高め、より強く発信していくことを基本方針としています。

当社は、「世界の半導体メーカーに対して、より良い製品を提供すること」をミッションとしており、その中核を担うのが測定技術です。現在もテストとハンドラを組み合わせたソリューションを提供しておりますが、測定技術の深化を通じてテスト事業を強化することで、ハンドラの需要拡大にもつながると見込んでおります。

特にパワー半導体は、技術革新のスピードが早く、それに伴いテストへのニーズも高度化しています。当社は、他社が手掛けていないニッチな領域にも着目し、そこに切り込むことで存在感を高めていきたいと考えています。各種統計からも明らかのように、パワー半導体は多少の波はあるとしても、今後も確実な成長が見込まれる注目市場です。

一方、ハンドラはある程度成熟した市場です。単にハードウェアとしてのハンドラ製品なら安いものはたくさん存在します。しかし、当社では競争力のあるラインナップを揃え、継続的な改良を重ねることで、顧客が求める生産性の向上に寄与できると考えています。特に、テストに至る前段階での省力化、あるいは無人化を意識したアプローチにより、テストソリューションとしての付加価値提供をさらに進めてまいります。

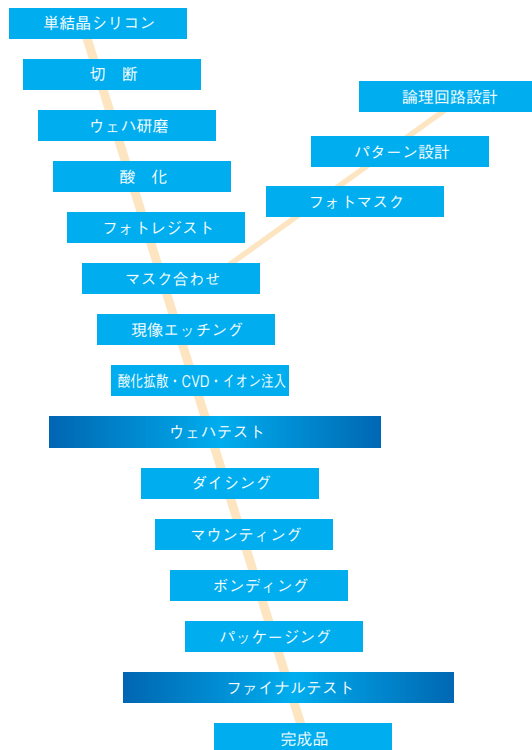
Q 最後に、株主様へのメッセージをお願いいたします。

A 当期の業績については、前回中期経営計画で掲げた目標には届かず、誠に残念な結果となりました。この結果を真摯に受け止めております。当社は、上場以降、景気変動や業界構造の変化を受け、厳しい業績が続いた時期も経験してまいりました。そのような状況下においても、技術開発力の向上、販売、生産体制の再構築など、一貫して企業体質の改善に取り組んでまいりました。こうした取り組みが徐々に成果を上げつつあり、経営基盤が整ってきた現在、私は今こそ当社が攻めに転じる局面にあると捉えております。

株主還元についても、従来は利益連動型である「総還元性向35%」を基本方針としてまいりましたが、新たな中期経営計画では、より安定的かつ資本効率を意識した配当を実現すべく、「DOE（連結株主資本配当率）4%」を目安とする方針へと転換いたしました。これにより、短期的な業績に左右されにくく、予見性と持続性のある株主還元を目指してまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも当社の取り組みにご理解を賜り、変わらぬご支援をいただけますようお願い申し上げます。

半導体検査装置の、
リーディングカンパニーとして、グローバルに、
そして独創的にカスタマーニーズにお応えしています。



製造された各種半導体の品質による分類・選別処理を自動的に行うハンドラ、ハンドラと連動して半導体の電気特性を高速・高精度で測定し、分類・選別の基準となるデータを提供するテスト。これら半導体検査装置は半導体の最終検査（ファイナルテスト）を担い、その精度は半導体、さらには電子機器などの最終製品の品質を決定するといっても過言ではありません。

また、近年は当社の強みである高電圧・大電流なパワー半導体（※）測定技術を継承しつつ、長年蓄積してきた測定技術を活用し、ウェハテスト工程に対応した新しいタイプのテストにも注力しております。複数チップを同時測定処理することにより、従来テストに比べ大幅に生産性向上を図ることができます。

テセックは、ハンドラとテストの専門メーカーとして、また、それらを組合わせたテストシステムのトータルサプライヤーとして、長年のノウハウと確かな技術力を駆使して、高品質・高信頼を追求してきました。

さらに今、トータルシステムや特化したカスタマーニーズへの対応など、検査装置の領域を超えたソリューションの提供にも積極的に挑戦しています。

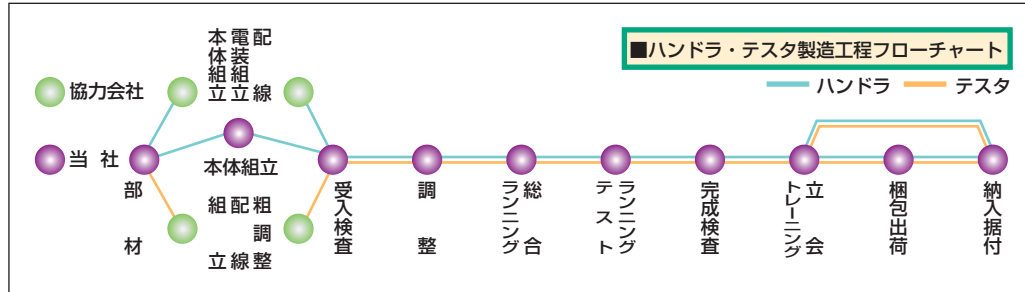
パワー半導体とは = 電力制御や供給機能がある半導体

例えば自動車では、
従来の内燃機関はガソリンなど燃料を使用 ⇒ 排気ガスを排出
パワー半導体は燃料を使わず、電気を使用
電気（電圧や電流）により動力を発生し制御 ⇒ 排気ガスゼロ



パワー半導体による地球温暖化抑制とCO₂削減が可能

この**パワー半導体**の信頼性試験に**当社製品**が貢献！



半導体業界は刻々と変わりゆく技術やデバイスの多様化によって、当社が手がける検査装置に求められるレベルも高度になりつつあります。このような時代の流れに対応するために、これまでも独自技術のオリジナリティを磨き、他社との差別化を図ってきました。すでに定評のあるハンドラとテストはもちろん、MEMSハンドラや一貫システムまで、最先端の市場を見据えた幅広いラインナップでカスタマーニーズにお応えしています。

ハンドラ

ハンドラとは、接続されたテストからの測定データを受け、設定されたレベルに応じて各種半導体デバイスを自動的に分類・選別する装置です。

チェンギットによりデバイスの形状、サイズ、重さなどの変化にも柔軟に対応でき、同時にコンパクト設計、シンプル機構、優れた操作性、低価格を実現しています。

対象半導体の種類、用途によっては温度試験対応などの機能が付加され、さらに半導体製造の後工程となるリード切断やマーキングを同時に行う一貫システムも充実しています。

テスト

テストとは、各種半導体デバイスの電気特性を高速・高精度に測定するテストシステムです。パソコンの搭載で、ウィンドウズの画面上で対話型式によるテストプログラムを簡単に作成でき、ネットワークにも接続できます。

特に大電流、高電圧に対応するテストシステムでは高度な計測技術により他社の追随を許さない性能を誇り、長年にわたって高シェアを維持しています。また、ロジックICを対象としたDC測定、時間測定、ファンクション測定などの分野もカバーしています。



MEMSテストハンドラ



パワーデバイス用パラレルテストシステム

半導体製造工場が稼働する世界全地域をカバー。 このネットワークが、信頼をより強固に。

リアルタイムの情報を世界各地から収集・分析し、製品や提案として発信するテセックのビジネスモデル。設立当時に、半導体先進国だったアメリカ系企業から技術力を認められ、いち早くグローバルに展開できたことが、独自性を際立たせるきっかけとなりました。以来今日まで拓かれた販売・サービス網は、半導体製造工場のある世界全域をカバーし、なかでもアメリカ、マレーシア、中国の現地法人では、現地のお客様に向けてきわめて密接な営業活動・情報収集を実践しています。そこから生まれる新たな製品・ソリューションは、海外代理店も巻き込んでまさにグローバルに波及し、世界各地での半導体ビジネスに貢献しています。

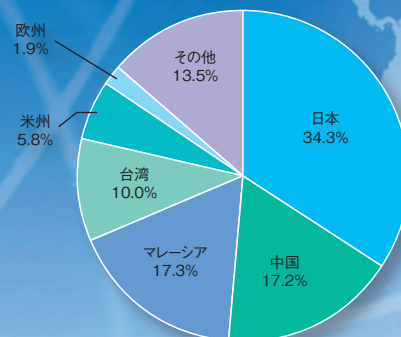
ドイツ
フランス

韓国
中国(上海)
台湾
タイ
マレーシア
フィリピン
伊那事業所(長野)
本社(東京)
嶺光音電機(神奈川)
テセック熊本(熊本)

アメリカ

- 国内事業所
- 国内子会社
- 海外現地法人
- 海外代理店

地域別売上高分布



連結貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	前連結会計年度 2024年3月31日現在	当連結会計年度 2025年3月31日現在
(資 産 の 部)		
流 動 資 産	11,208	9,300
現金及び預金	3,858	4,352
受取手形	7	－
電子記録債権	438	69
売掛金	1,974	1,782
有価証券	832	198
製品	202	131
仕掛品	2,693	1,840
原材料	822	786
未取還付法人税等	－	34
未収消費税等	256	－
その他	124	108
貸倒引当金	△ 2	△ 4
固 定 資 産	4,952	6,174
有形固定資産	1,506	1,840
建物及び構築物	2,506	2,554
減価償却累計額	△ 2,225	△ 2,244
建物及び構築物(純額)	280	310
機械装置及び運搬具	122	123
減価償却累計額	△ 109	△ 114
機械装置及び運搬具(純額)	12	8
工具、器具及び備品	724	706
減価償却累計額	△ 646	△ 629
工具、器具及び備品(純額)	77	76
土地	1,134	1,440
建設仮勘定	－	4
無形固定資産	430	539
ソフトウェア	15	11
ソフトウェア仮勘定	179	340
技術関連資産	234	184
その他	1	2
投資その他の資産	3,016	3,794
投資有価証券	2,618	3,399
退職給付に係る資産	173	164
繰延税金資産	2	1
保険積立金	207	208
その他	19	20
貸倒引当金	△ 4	－
資 産 合 計	16,161	15,474

科 目	前連結会計年度 2024年3月31日現在	当連結会計年度 2025年3月31日現在
(負 債 の 部)		
流 動 負 債	1,368	834
買掛金	151	74
未払金	215	86
短期借入金	－	40
1年内返済予定の長期借入金	－	47
未払費用	140	115
契約負債	208	161
未払法人税等	320	41
賞与引当金	194	143
製品保証引当金	79	47
修繕引当金	0	29
その他	58	47
固 定 負 債	315	475
長期借入金	－	276
退職給付に係る負債	－	56
資産除去債務	－	10
長期未払金	1	－
繰延税金負債	309	129
その他	4	2
負 債 合 計	1,683	1,309
(純 資 産 の 部)		
株 主 資 本	13,301	13,262
資本金	2,521	2,521
資本剰余金	3,381	3,382
利益剰余金	7,939	7,979
自己株式	△ 540	△ 620
その他の包括利益累計額	1,175	900
その他有価証券評価差額金	1,104	765
為替換算調整勘定	70	135
非支配株主持分	1	1
純 資 産 合 計	14,477	14,165
負 債 純 資 産 合 計	16,161	15,474

連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	前連結会計年度	当連結会計年度
	自：2023年4月1日 至：2024年3月31日	自：2024年4月1日 至：2025年3月31日
売 上 高	8,619	5,892
売 上 原 価	4,794	3,634
売 上 総 利 益	3,825	2,257
販売費及び一般管理費合計	2,094	1,822
営 業 利 益	1,731	434
営 業 外 収 益 合 計	421	257
営 業 外 費 用 合 計	14	16
経 常 利 益	2,137	674
特 別 利 益 合 計	3	－
税金等調整前当期純利益	2,141	674
法人税、住民税及び事業税	474	261
法 人 税 等 調 整 額	151	△ 13
法 人 税 等 合 計	625	247
当 期 純 利 益	1,515	427
非支配株主に帰属する当期純利益	0	△ 0
親会社株主に帰属する当期純利益	1,515	427

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	前連結会計年度	当連結会計年度
	自：2023年4月1日 至：2024年3月31日	自：2024年4月1日 至：2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー	871	1,767
投資活動によるキャッシュ・フロー	149	△ 900
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 691	△ 495
現金及び現金同等物に係る換算差額	224	89
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	554	461
現金及び現金同等物の期首残高	3,048	3,602
現金及び現金同等物の期末残高	3,602	4,063

連結対象子会社

日本	嶺光音電機株式会社（横浜市）
アメリカ	TESEC, INC. /Head Office（カリフォルニア州） /Arizona Office（アリゾナ州）
マレーシア	TESEC（M）SDN.BHD.
中国	泰賽国際貿易（上海）有限公司

連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

(単位：百万円)

	株主資本					その他の包括利益累計額			非支配株主持分	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他 有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	その他の 包括利益 累計額合計		
当 期 首 残 高	2,521	3,381	7,939	△ 540	13,301	1,104	70	1,175	1	14,477
当 期 変 動 額										
剰 余 金 の 配 当			△ 387		△ 387					△387
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益			427		427					427
自 己 株 式 の 取 得				△ 99	△ 99					△99
自 己 株 式 の 処 分		1		19	21					21
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）						△ 339	65	△ 274	△ 0	△ 274
当 期 変 動 額 合 計	－	1	40	△ 80	△ 38	△ 339	65	△ 274	△ 0	△ 312
当 期 末 残 高	2,521	3,382	7,979	△ 620	13,262	765	135	900	1	14,165

会社概要

社名	株式会社テセック TESEC Corporation
所在地	本社（〒207-0023） 東京都東大和市上北台三丁目391番地の1 TEL：042-566-1111（代） FAX：042-562-6161 伊那事業所（〒399-4601） 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪16346 TEL：0265-79-6611（代） FAX：0265-79-7883 テセック熊本（〒861-2202） 熊本県上益城郡益城町田原1155-12 テクノ・リサーチパーク テクノ・ラボラトリビル2F TEL：096-287-1551 FAX：096-287-1552
設立	1969年12月22日
資本金	25億21百万円
従業員数	214名（連結）、176名（単体）（2025年3月31日現在）
国内子会社	嶺光音電機株式会社
海外現地法人	TESEC, INC.（アメリカ） TESEC（M）SDN. BHD.（マレーシア） 泰賽国際貿易（上海）有限公司（中国）
事業内容	半導体検査装置であるハンドラ（半導体の電氣的測定結果をもとに性能毎に分類・選別する装置）、 テスト（半導体の性能を電氣的に測定する装置） およびパーツ等（予備部品、保守部品等）の開発・ 製造・販売
URL	https://www.tesec.co.jp

役員（2025年6月27日現在）

代表取締役社長	田中賢治
取締役	宮脇浩幸
取締役	渡邊弘一
取締役	戸田雄介
取締役（常勤監査等委員）	尾亦利夫
取締役（監査等委員）	南忠良
取締役（監査等委員）	舩川博昭

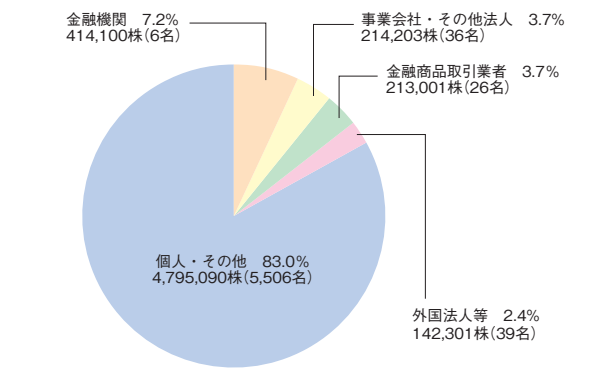
株式状況（2025年3月31日現在）

発行可能株式総数	20,000,000株
発行済株式の総数	5,778,695株
株主数	5,613名
大株主（上位10名）	

株主名	持株数	持株比率
田中 綏子	376千株	6.9%
村井 昭	196	3.6
日本生命保険相互会社	186	3.4
勝田 知男	177	3.2
山村 博	166	3.0
株式会社りそな銀行	164	3.0
中島 秀樹	139	2.5
テセック社員持株会	116	2.1
大塚 佳苗	106	1.9
大塚 正樹	103	1.9

（注）1.当社は、自己株式を301,142株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2.持株比率は自己株式を控除して計算しております。

所有者別株主数分布



株 主 メ モ

事業年度 4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会 6月
基準日 3月31日
株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社
連絡先 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
東京都府中市日鋼町1-1
電話 0120-232-711（通話料無料）
郵送先 〒137-8081
新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
同取次所 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店
公告方法 電子公告により行います。
ただし、事故その他やむを得ない事由
によって電子公告をすることができな
い場合は、日本経済新聞に掲載いたし
ます。
URL <https://www.tesec.co.jp>
1単元の株式数 100株

株式会社 テセック

本社 〒207-0023 東京都東和上市北台三丁目391番地の1
TEL 042-566-1111（代） FAX 042-562-6161
伊那事業所 〒399-4601 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪16346
TEL 0265-79-6611（代） FAX 0265-79-7883
テセック熊本 〒861-2202 熊本県上益城郡益城町田原1155-12
テクノ・リサーチパーク テクノ・ラボラトリビル2F
TEL 096-287-1551 FAX 096-287-1552

URL <https://www.tesec.co.jp>